

2018年3月期 第1四半期 決算説明資料



2017年7月31日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

1

用語の説明

用語	内容
PWB (Printed Wiring Board)	プリント配線板
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト（レジストインキ）
PKG (Package)	半導体パッケージ

② 当社グループの製品分野

分野	分類		性状	用途
PWB用 絶縁材料	リジッド	高機能品	液状	表層保護・絶縁用 S R 材料
		汎用品		
	PKG		液状 ／ドライフィルム	
	フレキ		液状 ／ドライフィルム	層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料
	ビルドアップ		液状 ／ドライフィルム	
その他 関連商材	その他		液状	マーキング・エッチング・めっき用材料 フラックス・溶剤等・導電性銀ペースト

③ 2018年3月期 第1四半期 トピックス

1

為替は想定レートより円安に推移

※（円・USD） 実勢レート：112円/想定レート:100円（2017年5月2日発表）

2

販売数量はDFを中心に前年同期比で増加

3

第2四半期（累計）および通期連結業績予想を修正

4

子会社（太陽ファルマ株式会社）の設立を発表

※ご参考 2017年6月22日プレスリリース「子会社の設立に関するお知らせ」

http://www.taiyo-hd.co.jp/_cms/wp-content/uploads/2017/06/20170622_03.pdf

4

2018年3月期 第1四半期 連結業績

連結業績サマリ

単位：百万円

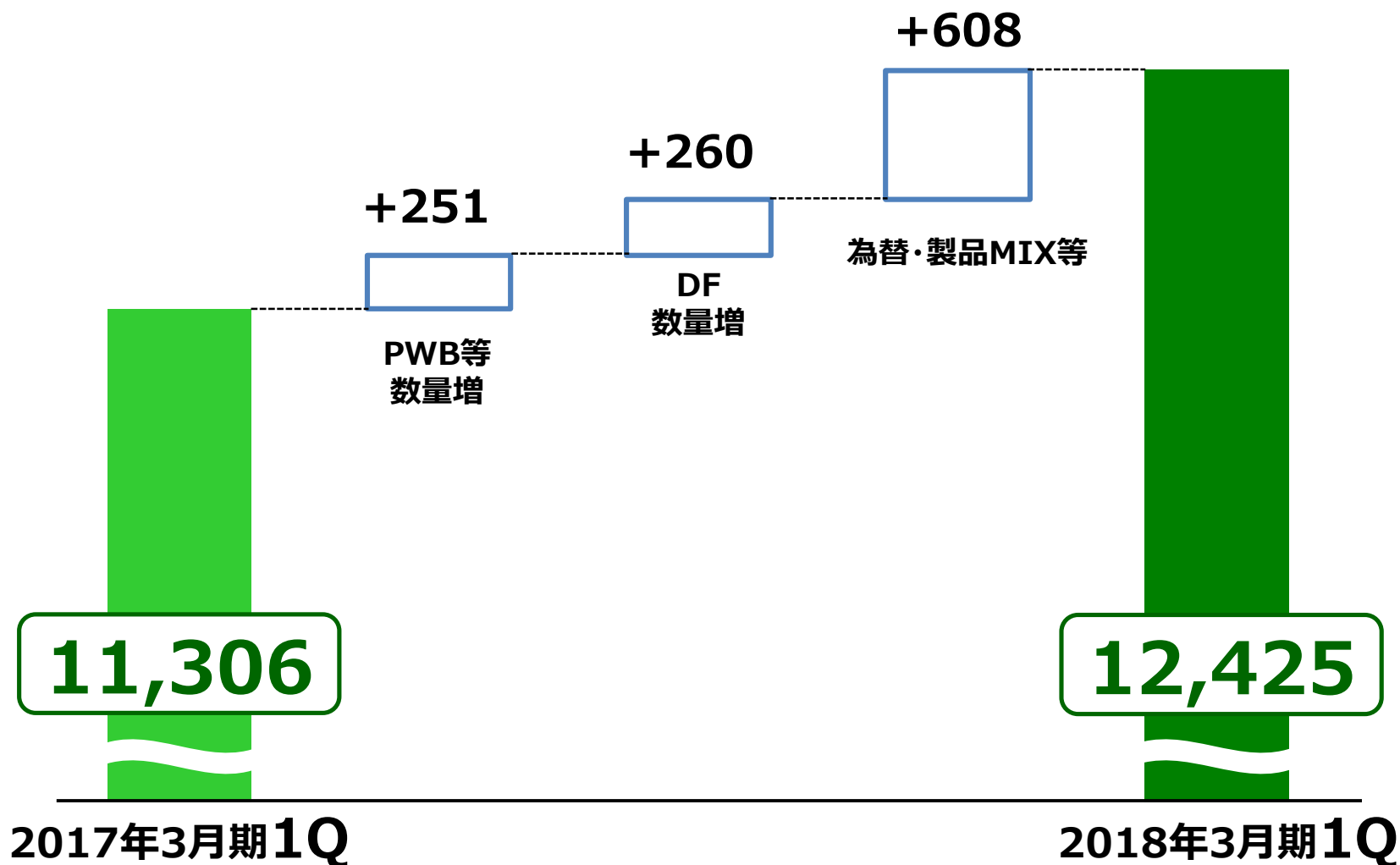
	2017年3月期 第1四半期 累計実績	2018年3月期 第1四半期 累計実績	前期比	増減率	2018年3月期 第2四半期（累計） 今回発表予想	進捗率
売上高	11,306	12,425	+1,119	+10%	25,000	50%
営業利益	2,139	2,714	+575	+27%	5,200	52%
経常利益	2,153	2,683	+530	+25%	5,100	53%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	1,876	1,844	-32	-2%	3,600	51%
円・USDレート	109	112			111	

5

2018年3月期 第1四半期 売上高（前期比）

売上高前期比分析

単位：百万円

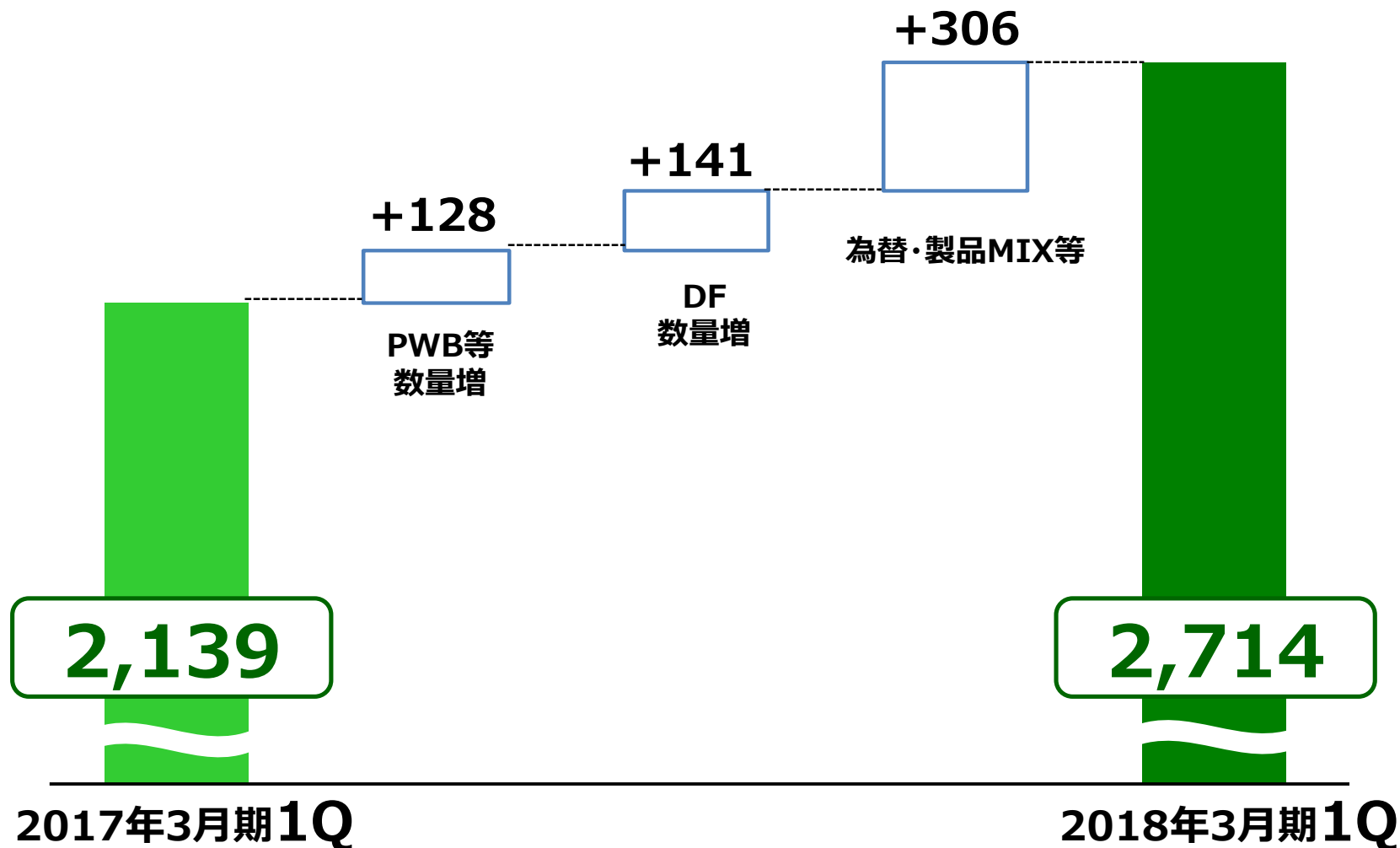


6

2018年3月期 第1四半期 営業利益（前期比）

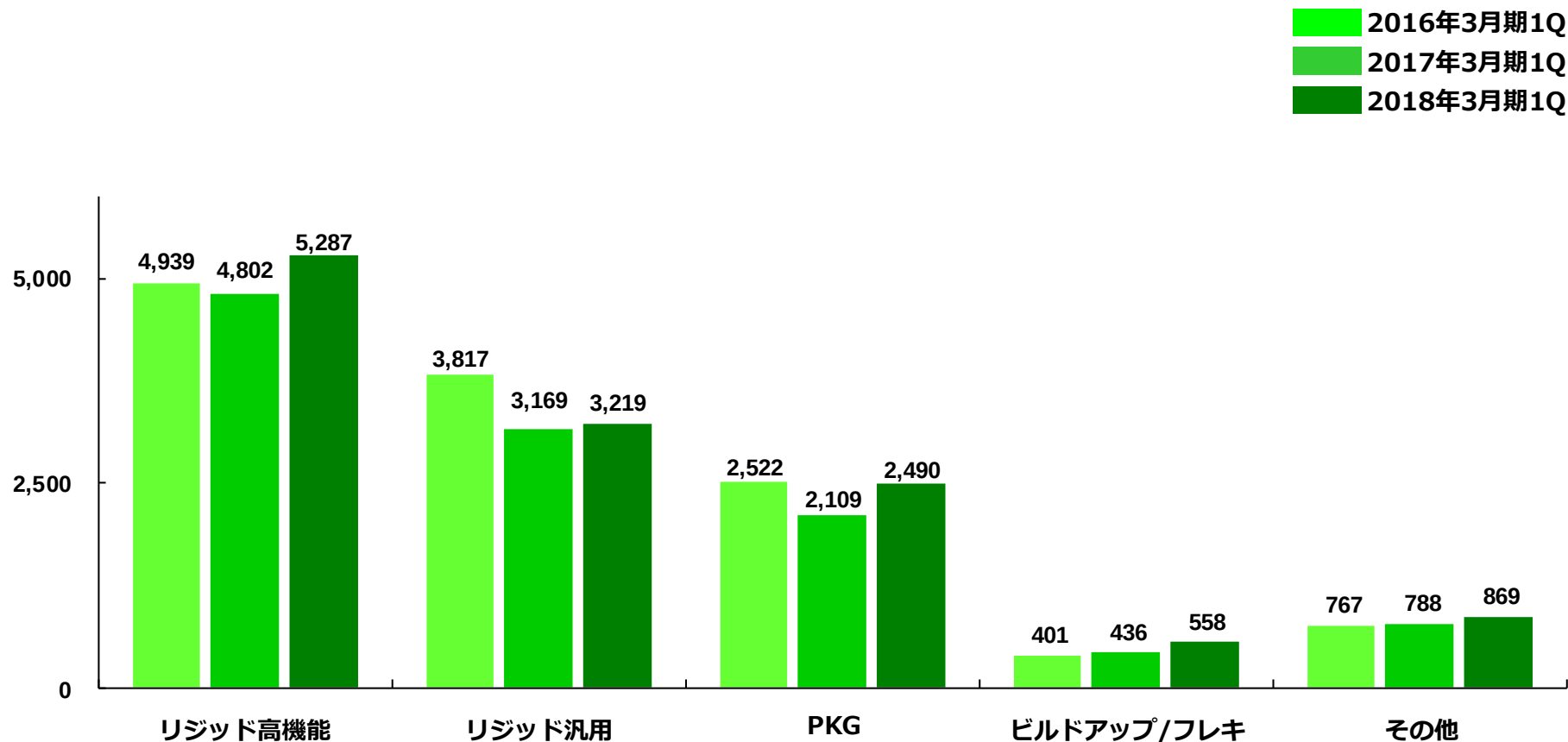
営業利益前期比分析

単位：百万円



製品区分別売上高

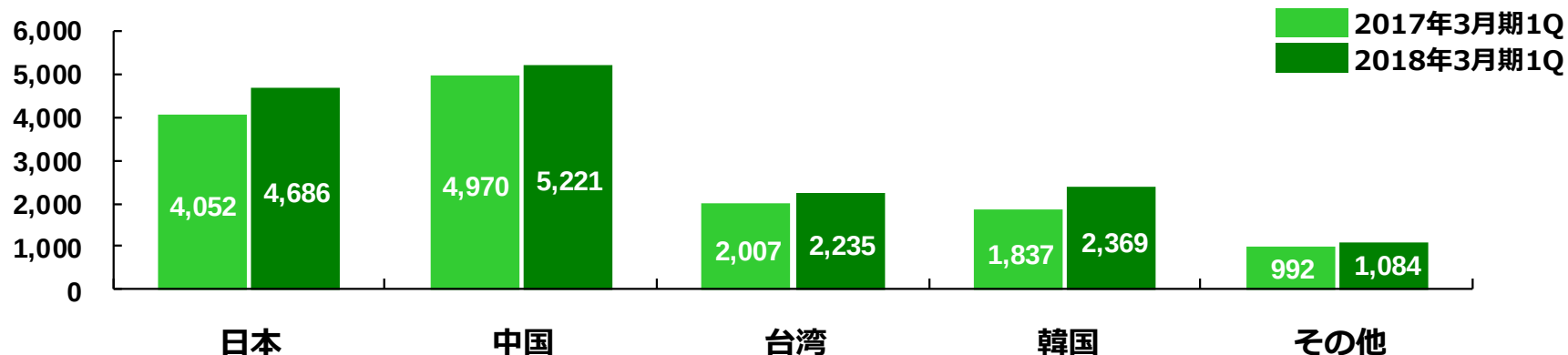
単位：百万円



※決算短信・有価証券報告書等に記載の「製商品品目別の販売実績」の分類と異なります。

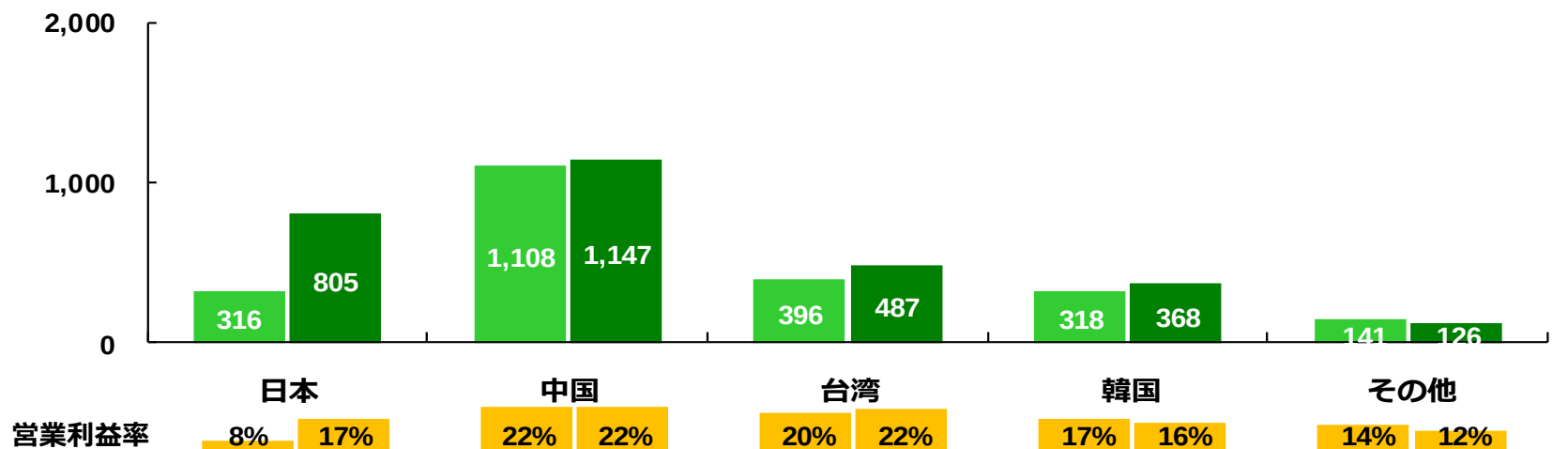
セグメント別：売上高 (グループ内売上含む)

単位：百万円



セグメント別：営業利益 (グループ内売上含む)

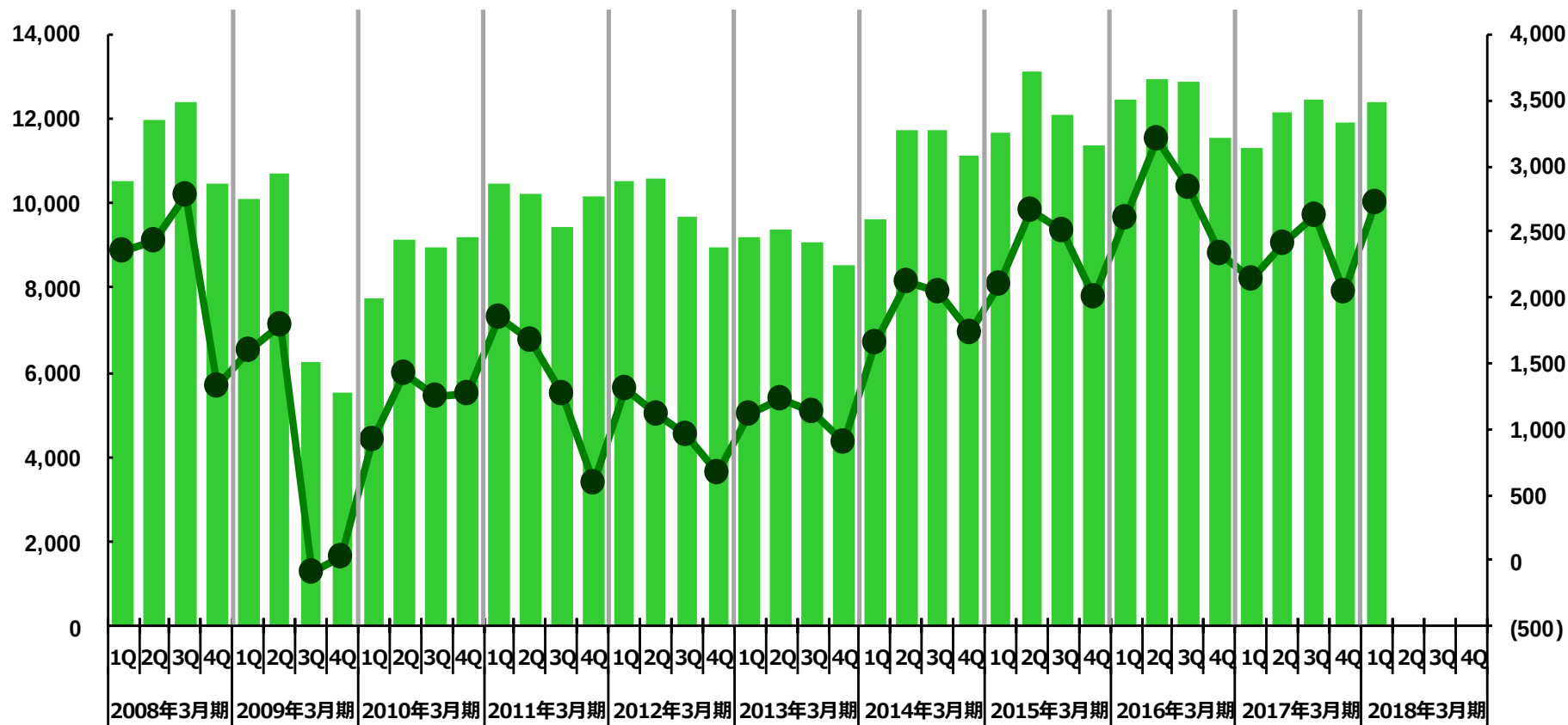
単位：百万円



四半期別推移：売上高/営業利益

単位：百万円

■ 売上高（左軸）
● 営業利益（右軸）



連結業績予想の修正

単位：百万円

	2018年3月期 第1四半期 累計実績	2018年3月期 第2四半期（累計） 前回 発表予想	2018年3月期 第2四半期（累計） 今回 発表予想	2018年3月期 通期 前回 発表予想	2018年3月期 通期 今回 発表予想
売上高	12,425	23,200	25,000	46,400	48,200
営業利益	2,714	4,100	5,200	8,100	9,200
経常利益	2,683	4,000	5,100	8,000	9,100
親会社株主に帰属 する四半期純利益	1,844	2,800	3,600	5,600	6,400
円・USDレート	112	100	111	100	106

当初計画より需要が上回ったこと及び為替レートが想定より円安で推移した結果、2017年5月2日発表の業績予想を上回る見通しとなり、第2四半期（累計）および通期連結業績予想を上記のとおり修正。

